|  |
| --- |
| **台湾商談会 企業エントリーシート　要望事項の記入** |

* **基本情報**

|  |  |
| --- | --- |
| ～　会社ロゴマークがあればここに入れる　～ | 企業名 |
| WebサイトURL |  |
| 所在地 |  |
| 設立年／従業員数 | 設立年：　　　　　　　　　　　従業員数：　　　　　　　　　　資本金： |
| 事業概況（紹介） |  |
| 担当者（役職） |  |
| 連絡先 | 電話：　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス： |
| 対応可言語 | □日本語　　　　　　　□台湾語　　　　　　　　□英語 |

* **求める技術・製品（Needs）＆マッチング希望条件**

|  |  |
| --- | --- |
| **＜商談希望 分類＞**（複数選択可） | □販売：売りたい□購入：買いたい□技術提携：連携、協業して事業を展開したい□現地サポート：ビジネス後に修理・メンテナンス・保守サポートをお願いしたい□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **＜ターゲット絞込み＞**対象分野・業種（複数選択可） | □半導体製造・加工（前工程）　　　□半導体製造・加工（後工程／検査・テスト）□材料・部材（前工程）　　　　　　　　□材料・部材（後工程）□製造装置の販売・修理（前工程）　□製造装置の販売・修理（後工程）□半導体デバイス設計・開発　　　　　　□検査・測定装置の販売・修理□制御ソフトウエア・システム開発　　　　□AI・データ解析技術　　　　　□人材派遣　　　　　　　　　　　□故障解析・構造解析　　　　□輸送・物流　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **＜具体的な商談内容＞**・求めている製品・部品・求めている技術の詳細・依頼したい内容（調達量、規模、納期） | ＊商談したい内容を具体的に記載する（ターゲットを明確にする） |

＝　ご記入お疲れ様でした、ご協力に感謝いたします　＝